

## 日月光一〇四年度第一季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 104 年 4 月 30 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇四年度第一季獲利報告，本公司一〇四年第一季之合併營業收入較一〇三年第四季下滑 16%，較一〇三年同期成長 18%，為新台幣 64,662 百萬元。茲將日月光一〇四年度第一季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

### 合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	104 年度 第一季	103 年度 第四季	103 年度 第一季
營業收入淨額	64,662	76,644	54,700
營業毛利	12,313	16,411	10,360
營業淨利（淨損）	6,292	9,846	5,085
稅前淨利（淨損）	5,506	9,579	4,299
所得稅利益（費用）	(856)	(1,475)	(730)
非控制權益	(181)	(240)	(119)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	4,469	7,864	3,450
基本每股盈餘(新台幣元)	0.58	1.02	0.45
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.56	0.99	0.44

### 綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	104 年度 第一季	103 年度 第四季	103 年度 第一季
營業收入淨額	38,605	43,884	34,351
營業毛利	9,995	13,772	8,253
營業淨利（淨損）	5,546	8,931	4,222
稅前淨利（淨損）	5,230	9,274	4,053
所得稅利益（費用）	(709)	(1,344)	(573)
非控制權益	(52)	(66)	(30)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	4,469	7,864	3,450

### 半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	55
電腦	11
汽車及消費性電子	34
其它	0
前十大客戶佔營收比重	53

銷售地區別佔比	%
北美	64
歐洲	10
台灣	16
日本	5
亞洲其它地區	5

封裝業務產品組合	%
Advanced Packaging	33
IC Wirebonding	58
Discrete and Others	9
封裝資本支出金額	67 百萬美元
打線機台數	15,772 台

測試業務產品組合	%
後段測試	74
晶圓測試	21
前段測試	5
測試資本支出金額	52 百萬美元
測試機台數	3,339 台

### 電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	47
電腦	17
消費性電子	18
工業用	11
汽車電子	6
其它	1
前十大客戶佔營收比重	89
EMS 資本支出金額	16 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2015 年第二季的業績展望如下：

- 半導體封測事業之整體產能應能成長 2%，產能利用率則增加 0-2%；
- 半導體封測事業之毛利率則與上一季相近；
- 電子代工服務生意量將接近過去兩季之中間值；
- 電子代工服務毛利率因顧客產品供應鏈問題，將較前季經正常化後之毛利率小幅下滑。